

Plaskon ALP-2 (197)

Еpoxy; Epoxide

Cookson Electronics - Semiconductor Products

Описание материалов:

This material is an epoxy encapsulant for high productivity packaging of very thin, stress-sensitive devices such as TSSOP's. Performance attributes are intended to meet or exceed JEDEC Level 1 for all packages and have no or limited post-mold cure, fast cure cycle times tailored to specific applications and excellent adhesion to Cu and Pd-Ni leadframes.

Главная Информация			
Характеристики	Полупроводникового Низкая гигроскопичность Лазерная маркировка Цикл быстрого формования Ускоренная Настройка Хорошая производительность формования		
Используется	Тонкостенная упаковка		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Литье из смолы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.98	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль			ASTM D790
22°C	2.22	MPa	ASTM D790
260°C	0.103	MPa	ASTM D790
Flexural Strength			ASTM D790
22°C	0.0120	MPa	ASTM D790
260°C	0.00108	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	146	°C	ASTM E1356
CLTE-Поток	9.8E-6	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность	1.0	W/m/K	ASTM C177
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+12	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	55	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (1 MHz)	3.80		ASTM D150
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (3.18 mm)	V-0		UL 94

Дополнительная информация

Recommended Storage Temperature: <5°C
Life @ 5°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 6 months
Life @ 22°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 2 days
Life @ 35°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 0.5 days
Spiral Flow, 175°C, 1000 psi: 90 cm
Shimadzu Viscosity, 175°C, 1000 psi: 43 poise
Ram Follower Gel Time, 175°C, 1000 psi: 17 sec
Ash Content: 87 %
Hydrolyzable Halides: <1 ppm
Moisture Absorption, 85°C/85%RH, 168 hrs: 0.23%
Cull Hot Hardness, Shore D: 79
Volume Resistivity, 22°C: 1e12 ohm-cm
Volume Resistivity, 150°C: 1e9 ohm-cm
All test specimens are transfer molded and post cured for 4 hours at 175°C

Linear Thermal Expansion, Alpha 1: 9.8 cm⁻⁶/cm/°C

Linear Thermal Expansion, Alpha 2: 39.3 cm⁻⁶/cm/°C

Инструкции по впрыску

Resin Transfer Molding:

Molding Temperature: 170 to 185°C

Molding Pressure: 750 to 1250 psi

In Mold Cure Time: 70 to 120 sec

Post Mold Cure Time, 175°C: 0 to 4 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

